

证券代码：300656

证券简称：民德电子

深圳市民德电子科技有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-01

投资者关系活动类别	☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☒其他：电话会议
参与单位名称	前海开源基金、中欧基金、康禧资本、温氏基金、东吴基金、瑞泉基金、长城财富保险、国泰君安资管、光大永明资管、承珞（上海）投资、上海赢动基金、上海标朴资管、平安银行、国信证券、财通证券、华创证券、国投证券、华安证券、长江证券、中信证券、东方证券、招商证券、天风证券
时间	2025 年 4 月 28 日
地点	线上会议
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：陈国兵 证券事务代表：杨佳睿
投资者关系活动主要内容介绍	首先介绍了民德电子 2024 年和 2025 年一季度主要财务数据情况，随后介绍了公司目前主要业务的发展情况，最后对投资者关心的问题进行了解答。 一、公司财务情况介绍 （一）2024 年财务情况 1、公司 2024 年实现营收 4.09 亿元，较 2023 年增加 993 万元，同比增长 2.49%；实现归属上市公司股东的净利润-11,391.58 万元，较上年同期减少 12,647.15 万元，同比减少 1,007.28%；归母净利润减少的主要原因有： （1）公司对收购泰博迅睿和广微集成产生的商誉分别计提了较大金额减值准备，2024 年合计计提商誉减值 8,198 万元，收购泰博迅睿和广微集成产生的商誉已全额计提。 （2）受参股的 3 家功率半导体生产企业经营业绩影响，公司按权益法核算的长期股权投资收益为-7100 万元：其中广芯微电子 2024 年一直处于产能爬坡阶段，收入规模较小，且自 2024 年开始计提固定资产折旧费用，全年亏损较大；晶睿电子产能在不断扩

张，2024 年销量同比增长 43%，但因整体市场的单价比较低，2024 年仍处于亏损状态；芯微泰克自 2024 年一季度开始量产以来，上量很快，但因为单片价格不高，同时前期的折旧费用也比较大，目前尚处于亏损状态。

（3）条码识别设备业务收入和利润相比上年同期实现 20%以上的增长，创公司成立以来的最好业绩，并持续为公司贡献稳定现金流。

3、商誉减值以及参股公司的长期股权投资收益，对公司的现金流不会造成影响。2024 年，公司经营活动产生的现金流净额 11,131.15 万元，较上年同期增加 1,365.62 万元，同比增长 13.98%，公司经营状况保持稳定提升。

（二）2025 年第一季度财务情况

2025 年一季度，公司实现营业收入 5,397.90 万元，较上年同期减少 1,170.62 万元，同比减少 17.82%；实现归属于上市公司股东的净利润 3,347.10 万元，较上年同期增加 3,326.69 万元，同比增长 16,299.56%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,770.52 万元，较上年同期减少 1,552.46 万元，同比减少 711.94%。主要原因是：

（1）公司于 2025 年 1 月完成对广芯微电子的控股收购，根据会计准则核算，公司合并广芯微电子产生了 5,099 万元的税后投资收益，是报告期内归属于上市公司股东的净利润及非经常性损益较上年同期大幅增加的主要原因；同时，因合并广芯微电子，公司新增商誉 15,866 万元。

（2）2025 年一季度，广芯微电子产能稳步提升，收入较上年同期有所增长，但项目仍处于产能爬坡阶段，整体收入规模较小，而设备折旧摊销及人员等固定成本随着产能的提升较上年同期增加，导致广芯微电子仍处于亏损状态，净利润同比减少；此外，广芯微电子于 2025 年 1 月纳入公司合并报表范围，公司持股比例的增加也对归属于上市公司股东的净利润产生了一定影响。

二、公司业务发展情况介绍

（一）功率半导体业务进展

公司自 2020 年收购功率半导体设计公司广微集成，开始进入到功率半导体领域时，就确立了清晰的发展思路：以 smart IDM 模式打通功率半导体关键产业链环节，通过经年累月的技术创新，不断提升功率半导体制造工艺水平，满足进口替代芯片的制造需求。

经过近 5 年的努力，我们公司已完成从晶圆原材料（晶睿电子）+晶圆代工（广芯微电子）+特种工艺代工（芯微泰克）+芯片设计（广微集成、丽隽、熙芯微）等功率半导

体产业链核心环节的布局，且所有核心环节工厂均已投产，我们打造 smart IDM 生态圈第一阶段的任务基本完成。

1、晶圆代工厂广芯微电子

晶圆代工厂作为整个产业链投资规模最大、技术难度最高、工艺流程最繁杂的环节，也是对公司构建长期护城河有重要影响力的核心战略资产，因此在 2024 年年初，我们启动了对广芯微电子的控股收购，2025 年 1 月 2 号完成了工商变更，广芯微电子已成为上市公司控股子公司，公司也成为国内少数控股晶圆代工厂，并在产业链核心环节均实现自主可控的功率半导体企业。

过去一年广芯微电子处于产能爬坡阶段，从设备、人员、供应链的各环节都不断在进行磨合，过程中我们也遇到了非常多的困难和挑战，产线产能逐步提升。广芯微电子已完成了 45V-200V 全系列一百多款 MOS 场效应二极管、200V-2,000V 系列高压/特高压 VDMOS 的产品开发及量产工作，并通过了 IATF 16949 汽车行业质量管理体系认证。接下来一年，广芯微电子最重要的工作仍是不断提升产销量，尽早实现经营净现金流转正和净利润转正，步入良性扩产阶段。

2、设计公司广微集成

2024 年，广微集成的 6 英寸晶圆代工产能已全部切换至广芯微电子，因切换新厂后，产品需要遵循严格的流程重新进行客户验证，以确保产品性能、质量、可靠性等方面的一致性，因此，2024 年广微集成沟槽式肖特基二极管（MFER）销量较少，收入及利润下降明显。目前，广微集成的产品已陆续通过客户验证，部分大客户已开始批量下单，同时，随着广芯微电子产能的释放，广微集成的收入也将相应提升。

3、特种工艺晶圆代工厂芯微泰克

芯微泰克聚焦于先进功率器件特种工艺晶圆代工业务，主要业务包括薄片/超薄片背道系列结构化工艺、重金属掺杂系列工艺、特殊金属工艺，芯微泰克已陆续与二十多家国内知名半导体设计公司和晶圆代工厂建立合作。芯微泰克 6/8 寸的硅基薄片/超薄片背道工艺目前月产能超过 4,000 片/月，6 英寸重金属掺杂工艺月产能超过 12,000 片，今年芯微泰克计划开发包括 8 英寸重金属掺杂工艺、SiC 薄片背道工艺等多种新工艺。今年 3 月芯微泰克已通过 IATF 16949 汽车行业质量管理体系认证，具备车规级产品生产能力。

4、晶圆原材料企业晶睿电子

晶睿电子的外延片产品持续保持扩产，2024 年外延片销量比上年同比增长了 43%，但因为目前产品单价比较低，晶睿电子仍处于亏损状态。从 2024 年开始，晶睿的 SOI、MEMS 传感器用双抛片、SiC 外延等高附加值产品已陆续实现量产，抛光片产能占比明显提升，今年一季度接到 SiC 外延片批量订单。晶睿后续将重点发展应用于传感器市场的半导体材料，提升特色化和高端化水平，不断提升公司利润水平及市场竞争力。

（二）AiDC 业务进展

2024 年，公司的 AiDC 业务收入创历史新高，在海外市场高速增长、国内新业务市场开拓不断推进的情况下，实现了超过 20%以上的增速，并为公司持续贡献稳定经营性现金流。AiDC 业务未来将会长期作为公司“现金奶牛”业务，持续为公司提供资金和信用支持。

三、问答交流

1、晶圆代工厂广芯微电子的产品结构、产能规划及进度？

答：目前广芯微电子已量产产品包括 45V-150V 全系列沟槽式肖特基二极管，200-2,000V 高压/特高压 VDMOS，每月稳定产能在 1 万片以上；随着市场对高压/特高压产品需求的增加，广芯微电子也对产品结构进行了调整，逐步增加 VDMOS 产品产能；同时，广芯微电子也在开发高压 BCD 产品，后续会根据市场情况和客户需求，动态调整产线产能结构。

2、中美关税政策对公司半导体设备采购是否有影响？

答：广芯微电子主要生产成熟制程的功率半导体器件，采购的生产线为日本整线设备，且均已到货，目前主要根据不同产品生产工艺新增不分填平补齐设备；广芯微电子也加大于国内半导体设备厂商的合作，更多使用符合要求的国产设备；目前来看中美关税政策对公司半导体设备采购影响不大。

3、中美关税政策对公司产品出口业务是否有影响？

答：AiDC 业务方面，公司没有直接出口到美国的业务，海外市场主要分布在“金砖国家”和“一带一路”沿线国家；功率半导体业务的客户大部分为国内客户；目前中美关税政策对公司产品出口业务没有影响。

4、晶睿电子外延片的产品价格及现在的产品结构？

答：晶睿电子主要产品包括 4/5/6/8 英寸的硅基外延片，自去年到现在产销量有所提升，但价格变化不大；晶睿电子已逐步增加了包括 SOI、MEMS 传感器用双抛片、SiC

	外延等高附加值产品的产能。 5、AiDC 业务是否有开拓在工业领域的应用场景？ 答：公司在条码识别业务战略升级为 AiDC 事业部后，赛道容量得到进一步拓宽，依托自身在条码识别领域深厚的技术积累和丰富的行业经验，基于 AI+CIS 平台技术，不断拓宽产品应用赛道，其中，应用于 IVD（体外诊断设备）行业的系列扫码及视觉检测设备推广顺利，已得到客户认可并开始批量采购；公司也在开发包括应用于工业自动化产线、电子产品缺陷检测等机器视觉类新产品，服务于更多优质客户，持续打造更具竞争力的产品。
附件清单（如有）	无
日期	2025-04-29